



kingston.com/emcp

eMCP

スペース制限のあるモバイル、IoT、組み込みアプリケーション向けの電力効率のよい優れた統合ストレージソリューション

Kingston ではさまざまな JEDEC 規格の eMCP コンポーネントを提供しています。eMCP では組み込みマルチメディアカード (eMMC) ストレージと LPDDR (Low-Power Double Data Rate) を設置面積の小さいマルチチップパッケージ (MCP) に統合しています。このソリューションにより集積度が高まり、全体のサイズが縮小します。eMCP は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、および各種の「IoT (Internet of Things)」デバイスなどのスペース制限のあるシステム用にストレージとメモリを組み合わせたコンポーネントに最適です。

主な利点

- 業界標準の eMMC インターフェイスを使用して、設計と製品の制限を簡素化するマネージド NAND フラッシュソリューションです。設計の複雑さを大幅に軽減し、適格性判定サイクルを短縮します。
- eMCP では高集積メモリとストレージの組み合わせにより、システム設計のスペースを縮小しますので、小型フォームファクタアプリケーションに最適なソリューションです。
- eMCP では低電力 DRAM により総消費電力を節減しますので、ウェアラブルやモバイル IoT 製品など多くのバッテリー式アプリケーションに最適なソリューションです。
- コンポーネント数が減るため、部品表も簡素化されます。
- パフォーマンス、電力、寿命などアプリケーション要件に合わせて複数のファームウェア構成を利用できます。

市場セグメント



スマートフォンとタブレット端末



ウェアラブル



AI アクセラレータ



IoT

eMCP の部品番号と仕様

LPDDR3 ベースの eMCP

製品番号	容量		標準		パッケージ	FBGA	動作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C ~ +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C ~ +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C ~ +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C ~ +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C ~ +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x ベースの eMCP

製品番号	容量		標準		パッケージ	FBGA	動作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	149	-25°C ~ +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C ~ +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C ~ +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C ~ +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.1	254	-25°C ~ +85°C